

NC257-2 SOLDADURA EN PASTA

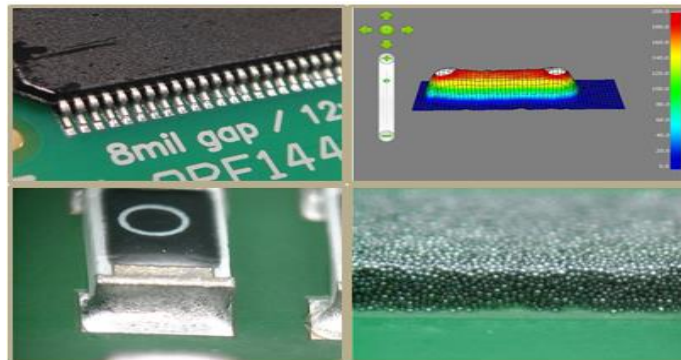
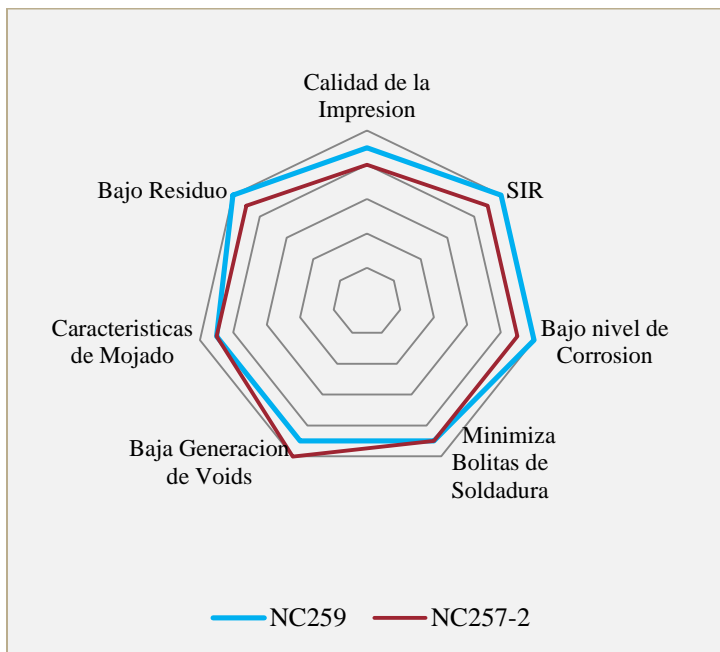
CARACTERÍSTICAS

- Cumple con la norma RoHS
- Minimiza la Generación de Vacíos y/o Huecos en Micro-BGA.
- Minimiza la Formación de Bolitas de Soldadura.
- Bajo Residuo de Flux y no Interfiere con las Pruebas Eléctricas.
- Excelente Acción Humectante y Mojado de Soldadura.
- Elimina el efecto de Head-in-Pillow.

DESCRIPCIÓN

La soldadura en pasta NC257-2 ha sido desarrollada para ofrecer amplias ventanas de proceso en impresión, características superiores de humectación y mojado que generan uniones de soldaduras lisas y brillantes, y con un bajo y claro residuo de flux que no interfiere con la inspección y con los contactos de las pruebas eléctricas. NC257-2 fue desarrollado para su uso en equipos de reflujo por convección y es compatible con procesos con N2 y fases de vapor. NC257-2 está formulado para extender el rendimiento del proceso de impresión y soportar largas pausas en instalaciones donde el control ambiental no es óptimo.

CARACTERÍSTICAS



MANEJO Y ALMACENAMIENTO

Aleación	Parámetro	Tiempo	Temperatura
Libre de plomo	Vida útil en Refrigeración	1 Año	0°C - 12°C (32°F - 54°F)
Libre de plomo	Vida útil sin Refrigeración	6 Meses	13°C - 22°C (55°F - 72°F)
Estaño-Plomo	Vida útil en Refrigeración	9 Meses	0°C - 12°C (32°F - 54°F)
Estaño-Plomo	Vida útil sin Refrigeración	4 Meses	13°C - 22°C (55°F - 72°F)

No mezclar pasta nueva y usada en un mismo contenedor. Sellar cualquier contenedor abierto mientras no esté en uso, en caso de usar tarros, colocar la tapa interior y exterior para asegurar el mejor sellado posible. Vea las guías de manejo de la pasta de AIM para más información.

LIMPIEZA

Antes del Reflujo: Se recomienda el uso del limpiador AIM DJAW-10 que remueve eficazmente los residuos de soldadura en pasta NC257-2 de la superficie de estenciles y aperturas. Puede ser aplicado a mano o con el sistema automático de limpieza del equipo de impresión de pasta. No se recomienda aplicar en exceso o directamente al estencil por la parte superior, no mezclar DJAW-10 con Alcohol Isopropilico (IPA) o cualquier otro solvente. Alcohol Isopropilico (IPA) puede ser utilizado al final del proceso de limpieza del estencil con DJAW-10 solo como enjuague.

Después del Reflujo: Los residuos la soldadura en pasta NC257-2 de AIM pueden permanecer sobre el ensamble después del reflujo y no requieren limpieza. Cuando un proceso limpio sea requerido, comuníquese con AIM para obtener mayor información sobre procesos limpios.

Document Rev # NF1
Page 1 of 3

CONDICIONES DE USO La información aquí contenida se basa en datos considerados como precisos y se ofrece sin cargo alguno. La información sobre el producto se basa en el hecho de asumir que el manejo y las condiciones de operación son los adecuados. No se acepta responsabilidad por pérdidas o lesiones que provengan del uso de esta información o de alguno de los materiales designados. Refiérase a <http://www.aimsolder.com/terms-conditions> para revisar términos y condiciones de AIM.





PERFIL DE REFLUJO


Se puede hallar información de perfil detallada en <http://www.aimsolder.com/reflow-profile-supplements>. Comuníquese con AIM para obtener información adicional.

IMPRESION

Configuración Inicial Recomendada – Varía de acuerdo al tipo y diseño del PCB o pad	
Parámetro	Valor Inicial Recomendado
Presión de las Navajas	0.4 - 0.7kg/25mm
Velocidad de las Navajas	13 – 152 mm/second
Distancia de Separación (Snap-off)	En contacto - 0.00 mm
Distancia de Desprendimiento entre PCB y estencil	0.75 - 2.0 mm
Velocidad de Desprendimiento entre PCB y estencil	3 - 20 mm/segundo

ESPECIFICACIONES TECNICAS

Nombre	Método de Prueba	Resultado	
Clasificación de flux por IPC	J-STD-004	ROL0	
Nombre	Método de Prueba	Resultado	Imagen
Prueba de Corrosión Inducida por el Método Espejo de Cobre	J-STD-004 3.4.1.1 IPC-TM-650 2.3.32	BAJO	
Pruebas de Propiedades Corrosivas de los Residuos de Fundente.	J-STD-004 3.4.1.2 IPC-TM-650 2.6.15	PASA	<div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <p>Antes</p>  </div> <div style="text-align: center;"> <p>Después</p>  </div> </div>
Bomba de Oxígeno Contenido de Haluro(s)	EN14582:2007 SW 9056 SW 5050	Br 585 mg/Kg Cl < 247 mg/Kg	
Presencia de Haluro(s) por Método de Cromato de Plata	J-STD-004 3.5.1.1 IPC-TM-650 2.3.33	PASA	
Presencia de Fluoruro(s) por Método de Punto	J-STD-004 3.5.1.2 IPC-TM-650 2.3.35.1	PASA	
Resistencia Aislante de la Superficie (SIR)	J-STD-004 3.4.1.4 IPC-TM-650 2.6.3.7	PASA	
Migración electroquímica	J-STD-004 3.4.1.5 IPC-TM-650 2.6.14.1	PASA	
Índice de Acidez del Fundente	J-STD-004B 3.4.2.2 IPC-TM-650 2.3.13	150 mg KOH/ g Valor Típico	

Nombre	Método de Prueba	Resultado	Imagen
Viscosidad	J-STD-004 3.4.2.4 IPC-TM-650 2.4.34	500-900 kcps	
Inspección Visual	J-STD-004 3.4.2.5	Gris, Suave, Cremosa	
Prueba colapsamiento de la Soldadura en Pasta (slump)	J-STD-005A 3.6 IPC-TM-650 2.4.35	PASA	
Prueba de Esfera de Soldadura	J-STD-005A 3.7 IPC-TM-650 2.4.43	PASA	
Prueba de retención (Tack)	J-STD-005A 3.8 IPC-TM-650 2.4.44	30 gf Valor Típico	